

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 1 日 (01.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/081024 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G02B 6/12, C08G 59/18
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/003026
- (22) 国際出願日: 2005 年 2 月 24 日 (24.02.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-049825 2004 年 2 月 25 日 (25.02.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 関西ペイント株式会社 (KANSAI PAINT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6618555 兵庫県尼崎市神崎町 3 3 番 1 号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 樋口 貴祐 (HIGUCHI, Takahiro) [JP/JP]; 〒2548562 神奈川県平塚市東八幡 4 丁目 1 7 番 1 号 関西ペイント株式会社内 Kanagawa (JP). 今井 玄児 (IMAI, Genji) [JP/JP]; 〒2548562 神奈川県平塚市東八幡 4 丁目 1 7 番 1 号 関西ペイント株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 三枝 英二, 外 (SAEGUSA, EIJI et al.); 〒5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 T N K ビル Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE RESIN COMPOSITION FOR LIGHT GUIDE FORMATION, CURABLE DRY FILM FOR LIGHT GUIDE FORMATION, CURED RESIN AND LIGHT GUIDE

(54) 発明の名称: 光導波路形成用硬化性樹脂組成物、光導波路形成用硬化性ドライフィルム、樹脂硬化物及び光導波路

(57) Abstract: A curable resin composition for light guide formation, capable of forming a cured resin that excels in thermal stability, mechanical strength and transparency and has properties, such as low thermal expansion and low transmission loss, required for light guide formation; and a curable dry film for light guide formation therefrom. There is provided a curable resin composition for light guide formation, comprising hydrolyzable-silyl-containing silane-modified epoxy resin (A) having, per molecule, an average of one or more hydrolyzable silyl groups and an average of one or more epoxy groups, and resin (B) having, per molecule, an average of one or more functional groups capable of reacting with an epoxy group. There is further provided a curable dry film for light guide formation, produced from the resin composition.

(57) 要約: 耐熱性、機械的強度、透明性に優れ、低熱膨張、低伝送損失などの光導波路形成に必要な特性を備えた樹脂硬化物を形成できる光導波路形成用硬化性樹脂組成物並びに光導波路形成用硬化性ドライフィルムを提供する。本発明は、1 分子中に平均 1 個以上の加水分解性シリル基と平均 1 個以上のエポキシ基とを有する加水分解性シリル基含有シラン変性エポキシ樹脂 (A)、及びエポキシ基と反応しうる官能基を 1 分子中に平均 1 個以上有する樹脂 (B) を含有してなる光導波路形成用硬化性樹脂組成物; 並びに、該樹脂組成物によって形成される光導波路形成用硬化性ドライフィルムを提供する。

WO 2005/081024 A1